



# 深度\*行业\*半导体行业周报：盛美推出12英寸晶圆单片SPM设备 全球代工市场即将突破千亿美元大关



国产光刻胶正逐渐获得国内产线认可，国产半导体设备厂商持续推新，有力推动新工艺覆盖和国产整代进程。市场主流预测晶圆代工市场及设备需求将持续以较高速增长，封测市场也将保持高景气，半导体全产业链持续受益。

蝶续推荐半导体设备、材料等板块机会。

行业动态：

IPO 进度：概伦电子、炬光科技成功过会，思科瑞将于 9 月 29 日科创板首发上会。截止 2021/9/26，共有 113 家半导体企业中报 IPO、开展上市辅导等，其中，FPGA 芯片供应再安路科技已注册，EDA 软件供应商概伦电子和半导体激光厂商炬光科技成功过会，EDA 软件供应商国微思尔芯已进行问询砷化基站射领 IC 设计商国博电子申报材料获受理半导体材料：广信材料光刻胶初试结果符合工艺要求，北京科华光刻胶获得长江存储、广州粤芯等订单。据广信材料在投资者互动平台表示，光刻胶产品已在进行试制送样，并陆续在相关厂商排用上线测试，日前送样的光刻胶产品初试结果符合工艺要求，与现用物料效果一致。据彤程新材在投资者互动平台表示，今年上半年旗下北京科华新增包括 KrF 光刻胶、高档|线光刻胶、化学放大型|线光刻胶在内的 10 支产品获得长江存储、中芯北方、广州粤芯、厦门士兰集科等用户订单。

半导体设备：盛美半导体推出的 300mm 晶圆单片 SPM 设备已交货。据盛美半导体设备官微消息，盛美半导体布了一款 300mm 晶圆单片 SPM

(硫酸和过氧化氢混合酸) 设备, 可广泛应用于先进逻辑、DRAM, 3D-NAND 等集成电路制造中的湿法清洗和刻蚀工艺, 尤其针对处理高剂量离子注入后的光刻胶 (PR) 去除工艺, 以及金属刻性、测离工艺。新产品的成功出货意味着盛美半导体的 SPM 工艺产品系列得到扩充且覆盖高温 SPM 的工艺步, 随着技术节点推进到 10nm 及以下, 这些步骤数量将越来越多, 公司业务将持续受益

晶固代工: 今年代工市场将首次超过 1000 亿美元大关, 同比强劲增长 23%。

据市场研究机构 iCInsights 最新数据显示, 受益于 5G 智能手机处理器、网络和数据中心处理器等应用的推动, 今年代工市场有望实现创纪录的 23% 增长, 达到 1072 亿美元, 其中, 预计今年纯代工市场将强劲增长 24%, 达到 871 亿美元, 超过去年 23% 的增长速度, 而 IDM 代工市场将增长 18%, 达到 201 亿美元。预计后续将继续以强劲的 11.6% 同比速度增长, 到 2025 年总代工销售额预计将达到 1512 亿美元

封装测试: 预测 2014-2026 年先进封装市场营收将翻一番达到 475 亿美元据 Yole 发布关于先进封装市场的最新报告, 预测 2014-2026 年间先进封装市场营收将翻一番。2020 年为 300 亿美元, 2026 年将达到 475 亿美元, 2014-2026 年 CAGR 为 7.4%。其中预计 3D 堆叠、ED 和 Fan-Out 的营收 CAGR 最高, 在 2020 年-2026 年间分别达到 22%、25% 和 15%。

投资建议:

设备组合：中微公司、北方华创、芯源概、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、迈为股份；建议关注：晶盛机电、光力科技、神工股份：

材料组合建议关注：沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂、形程断材、晶瑞电材、中环股份、

鼎龙股份

功率半导体组合：新洁能、华润微：建议关注：斯达半导、士兰版、闻泰科技

模拟建议关注：圣邦股份、思瑞浦、卓胜微 (射频) MCU：兆易创新；建议关注中颖电子

其他：

韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技风险提示

疫情影响超预期：半导体设备国产化进程放；半导体材料国内市场增

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_27097](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27097)

